**证券代码：688409 证券简称：富创精密**

**沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表**

**编号：【20250901】**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 ☑路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 恒泽投资、兴全基金、西部证券、中邮证券、Bernstein、鹏华基金、摩根士丹利、大成基金、博时基金、景顺长城、宝盈基金、招商基金、招银理财（以上排名不分先后） |
| **会议时间** | 2025年9月3日-2025年9月11日 |
| **会议地点** | 现场会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书：梁倩倩女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、投资者Q&A环节**  **Q1****：请问如何看待半导体零部件行业规模的成长趋势及可持续性？**  **A：**据SEMI预测，全球半导体制造行业持续强劲增长，预计2024年底至2028年，全球产能将以7%的复合年增长率增长，先进工艺设备资本支出预计从2024年的260亿美元增长至2028年的500亿美元以上，年复合增长率高达18%。2025年全球半导体设备销售额预计达1,255亿美元，2026年1,381亿美元，实现连续三年增长。  以SEMI最新预测为基准，全球半导体零部件市场规模将超600亿美元，中国大陆半导体零部件市场规模超263亿美元。具体情况详见公司《2025年半年度报告》  **Q2：请问在当前半导体零部件行业竞争格局下公司的竞争优势有哪些？**  **A：**从行业发展趋势看，由于半导体零部件领域存在较高的技术壁垒，"强者恒强"的竞争格局将持续深化。头部企业将通过全球化布局、产能扩张和技术创新来强化竞争优势，同时依托产业链协同效应构建更深的护城河。  公司以“平台化能力+全球化布局”构建竞争壁垒，坚持自主研发和外延投资的双轮驱动。在市场端，公司同步服务国内外头部企业，具有较好的客户资源；在产品端，公司覆盖机械及机电零组件和气体传输两大品类；在研发端，公司紧跟国际先进制程，研发先进技术，突破表面处理核心技术，适配先进制程需求；在制造端，公司垂直整合精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装以及检测等全链条能力，客户可一站式采购，降低管理成本；在产能端，公司在境内外设置生产基地，储备产能；在投资端，公司联合投资人共同收购国际品牌Compart公司，加速富创气体传输系统产品的市场竞争力。  公司会持续加速构建全球化业务平台，通过上下游产业链协同等方式加强实力壁垒，将行业头部效应发挥的更加明显。  **Q3：请问公司海外业务的可持续性如何？**  **A：**公司基于对半导体产业链“区域化重构”的前瞻预判，率先构建以属地化工厂为载体的全球化产能矩阵，通过物理隔离与本地化生产满足国内外客户对技术保密性及IP安全的刚性需求，为国内外客户提供符合要求的“可信制造环境”。同时，新加坡的区位优势带来显著政策红利，未来将转化为终端产品价格竞争力。  在运营层面，公司通过“本地工厂-区域客户”的短链模式，有效分散区域政策风险。多极增长模式与平台化技术底座深度融合，使公司能够持续优化资源配置效率，在半导体行业技术密集与资本密集的双重属性下，多极化的产能节点与平台化能力形成战略协同，持续优化全球供应链响应速度，构筑起难以被竞争对手复制的综合优势。  **Q4：请问公司在先进制程方面有哪些技术储备？**  **A：**在精密机械制造方面：通过“大型腔体一站式加工技术”实现大型腔体700余个尺寸工位连续加工，成为国内稀缺的一站式解决方案供应商，并持续开发800+工位的先进制程腔体，满足严苛形位公差与耐腐蚀要求；通过“超高精密加工技术”实现μm级形位公差控制，成功交付超临界清洗设备核心零部件  在表面处理方面：公司已成功突破晶圆生产环境严苛挑战，面对纳米级粒子污染控制、超高洁净度及极端耐腐蚀性要求，公司构建了以“耐腐蚀涂层技术”为核心、“高洁净度精密清洗技术”为支撑的先进表面处理工艺体系，通过提前布局大客户联合研发战略，实现从技术学习到自主创新的跨越。  在焊接工艺方面：使用超洁净管路焊接技术后的零件洁净度可达到主流国际客户标准，在先进制程中实现无颗粒化及气体管路内焊缝零氧化，为半导体设备提供高可靠性气体传输方案；应用“真空钎焊技术”的匀气盘、加热盘和抛光盘等核心零部件，钎着率显著高于行业标准水平。  **Q5：请问公司如何实现营收增长？**  **A：**作为国内半导体设备精密零部件的领军企业，公司将持续把握广阔的市场前景，坚定推行大客户战略，在积极拓展新客户的同时，深挖现有客户需求，通过服务国内外大客户，构建行业领先的研发创新能力，持续强化知识产权保护和技术壁垒优势，同步推进产能建设与全球化布局，实现营收的稳健增长。  **Q6：请问公司在匀气盘方面的研发进展？**  **A：**作为长期服务国内外领先客户的半导体设备精密零部件企业，公司持续推进技术升级与产品迭代，强化研发能力并深化市场拓展。在匀气盘领域，螺纹斜孔匀气盘已实现规模化量产，成功应用于PEALD机台；加热匀气盘于报告期内完成研发并加速推进客户验证，可适配 CVD、ETCH等核心机台；交叉孔焊接匀气盘具有复杂结构并对焊接工艺具有超高要求，公司成功在报告期内实现量产突破，主要配套ALD、PVD设备。  **Q7：请问公司各地工厂产能情况？**  **A：**截至目前，公司国内的生产基地包括沈阳工厂、北京工厂、南通工厂。沈阳工厂处于满产状态，南通工厂和北京工厂处于产能爬坡阶段。新加坡工厂已于2024年通过核心客户认证，产能逐步释放中。  **Q8：请问公司与compart公司是否有协调效益？**  **A：**2025年上半年，公司气体传输系统业务发展符合预期，订单同比增长53%，营收同比增长21%。公司将持续深化与Compart的业务技术协同，加速国产化进程和全球市场份额扩张。  **Q9：请问公司利润承压原因？**  **A：**公司利润总额同比下降，主要系公司为积极应对国内外半导体市场变化，把握行业长期发展的机遇，围绕“产能前置、技术前置、人才前置”的中长期战略，主动加大了在关键资源、先进产能及人才方面的前瞻性投入，这些面向未来的战略性举措导致公司利润指标出现阶段性承压。随着南通、北京及新加坡基地产能逐步释放，叠加规模效应显现，公司边际成本有望降低，盈利水平会进一步提升。 |
| **附件清单（如有）** | 风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 |
| **关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明** | 不涉及 |